

Technické možnosti výroby plošných spojů v kooperaci s asijským partnerem

1 Typ plošného spoje	jednostranné, dvoustranné, vícevrstvé FR-4, FR-5, CEM-3, CEM-1, Metal Base(hliník), High TG,
2 Materiál	Halogen Free
3 Maximální počet vrstev	20 vrstev HAL - bezolovnatý cín, HAL - olovnatý cín, ENIG- chemické zlato, imersní cín, galvanické zlato, OSP
4 Povrchové úpravy	
5 Minimální šířka spoje	0,10 mm (4 mil)
6 Minimální mezera mezi spoji	0,08 mm (3 mil)
7 Minimální otvor vrtaný	0,20 mm (8mil)
8 Minimální otvor laser	0,10 mm (4 mil)
9 Prokovené otvory tolerance	±0.076 mm (3mil)
10 Neprorokované otvory tolerance	±0.05 mm (2mil)
11 Pozice díry tolerance	±0.05 mm (2mil)
12 Minimální tloušťka desky	1-2 vrstvy : 0.10 mm (4mil) 4 vrstvy : 0.6 mm (24mil) 6 vrstev : 1.00 mm (39mil) 8 vrstev : 1.20mm (47mil)
13 Maximální rozměr desky	1 - 2 vrstvy : 530 mm × 630 mm (21"×25") vícevrstvé : 500 mm × 600 mm (20"×24")
14 Tloušťka desky	0.2 mm ~ 6.00 mm vnitřní vrstva: 1.40 μm (4oz), venkovní vrstva: 1.75μm (5oz)
15 Maximální tloušťka mědi	
16 Tloušťka desky tolerance	(t ≥1.0mm) ± 10% (t < 1mm) ± 0.1mm
Minimální vzdálenost spoj-hrana	
17 desky	0.15 mm
18 Obrys desky tolerance	±0.15 mm
19 Zkušební napětí	50V-300V
20 Zkosení zlacených pinů	úhel: 30-45-60, hloubka: 1-3mm
21 V - drážka	úhel: 30-35-45
22 Kontrola impedance	±10%
23 Slepé / pohřbené otvory	ano
24 Teplotní šok	288°C (3X10 s)
25 Ohýbání a kroucení	0.5%(min)
26 Otěruvzdornost nepájivé masky	≥6H
27 Hořlavost	94V-0